

2022年度 第3四半期 決算説明資料

2023.1.24

将来の見通しに関する注意事項

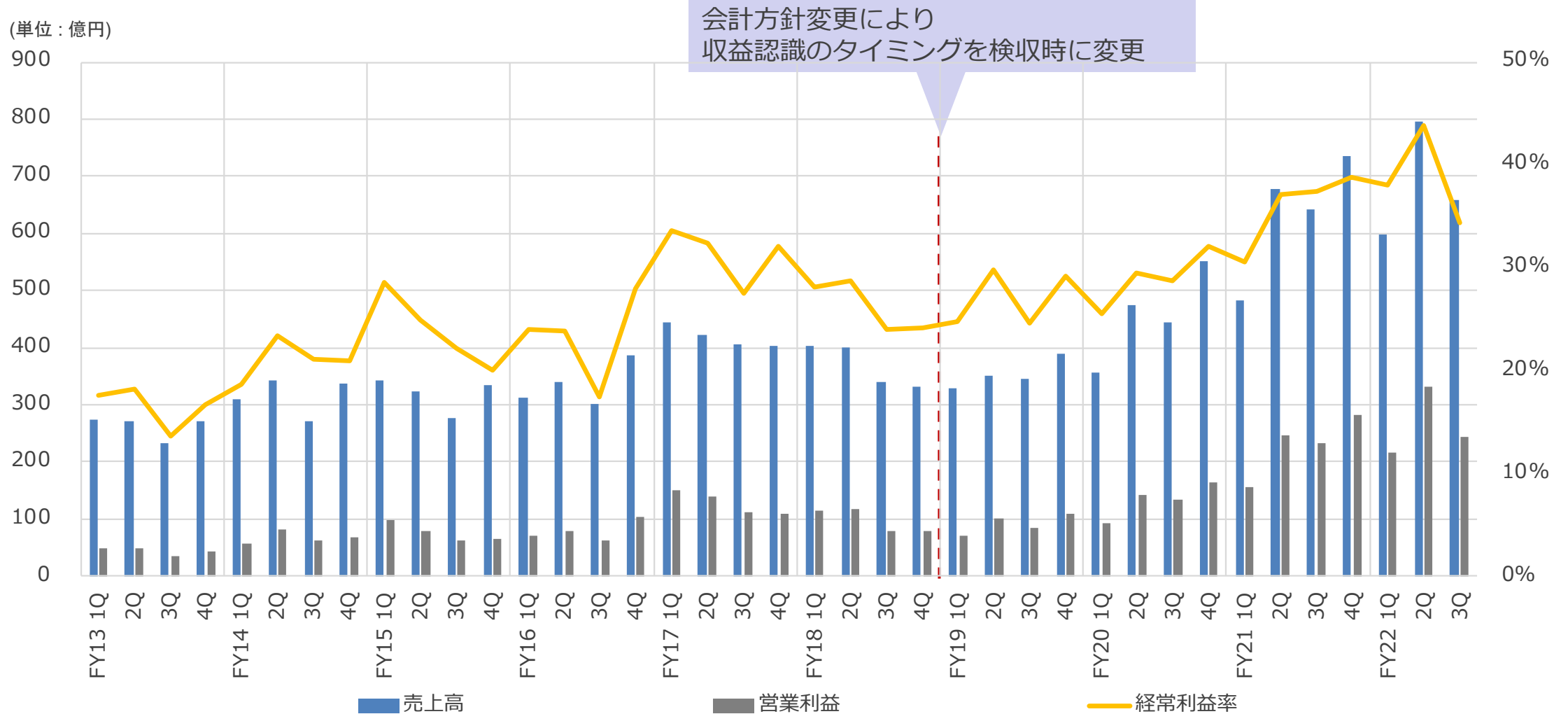
このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

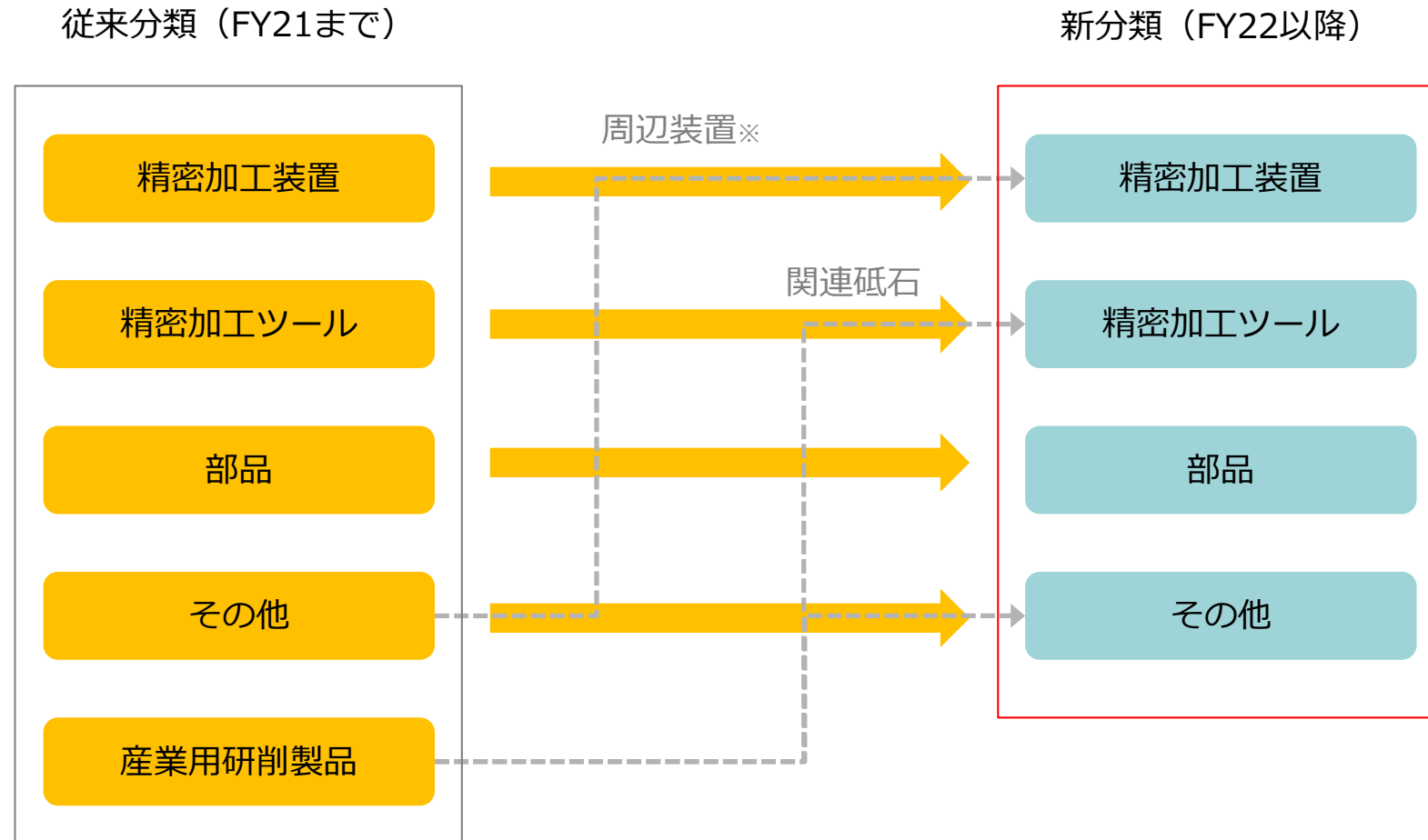
実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

(単位：百万円)	FY2022	FY2022	QoQ		FY2021	YoY	
	3Q	2Q	差額	(%)	3Q	差額	(%)
売上高	65,838	79,532	-13,694	-17.2%	64,186	1,652	2.6%
売上総利益	43,092	52,055	-8,963	-17.2%	39,157	3,935	10.0%
GP率	65.5%	65.5%	0.0p	-	61.0%	4.5p	-
販売管理費	18,835	18,776	58	0.3%	15,865	2,970	18.7%
営業利益	24,257	33,278	-9,021	-27.1%	23,292	965	4.1%
経常利益	22,605	34,819	-12,214	-35.1%	24,001	-1,396	-5.8%
経常利益率	34.3%	43.8%	-9.5p	-	37.4%	-3.1p	-
税前利益	22,522	34,798	-12,276	-35.3%	23,901	-1,379	-5.8%
純利益	16,546	24,633	-8,087	-32.8%	16,916	-371	-2.2%

売上高： YoY 高水準の出荷および為替影響で増加 QoQ 検収タイミングによる変動
 GP率： YoY 為替の影響や改善活動の継続などで収益性上昇 QoQ 高水準で推移
 販売管理費： 研究開発費などの増加により高水準で推移



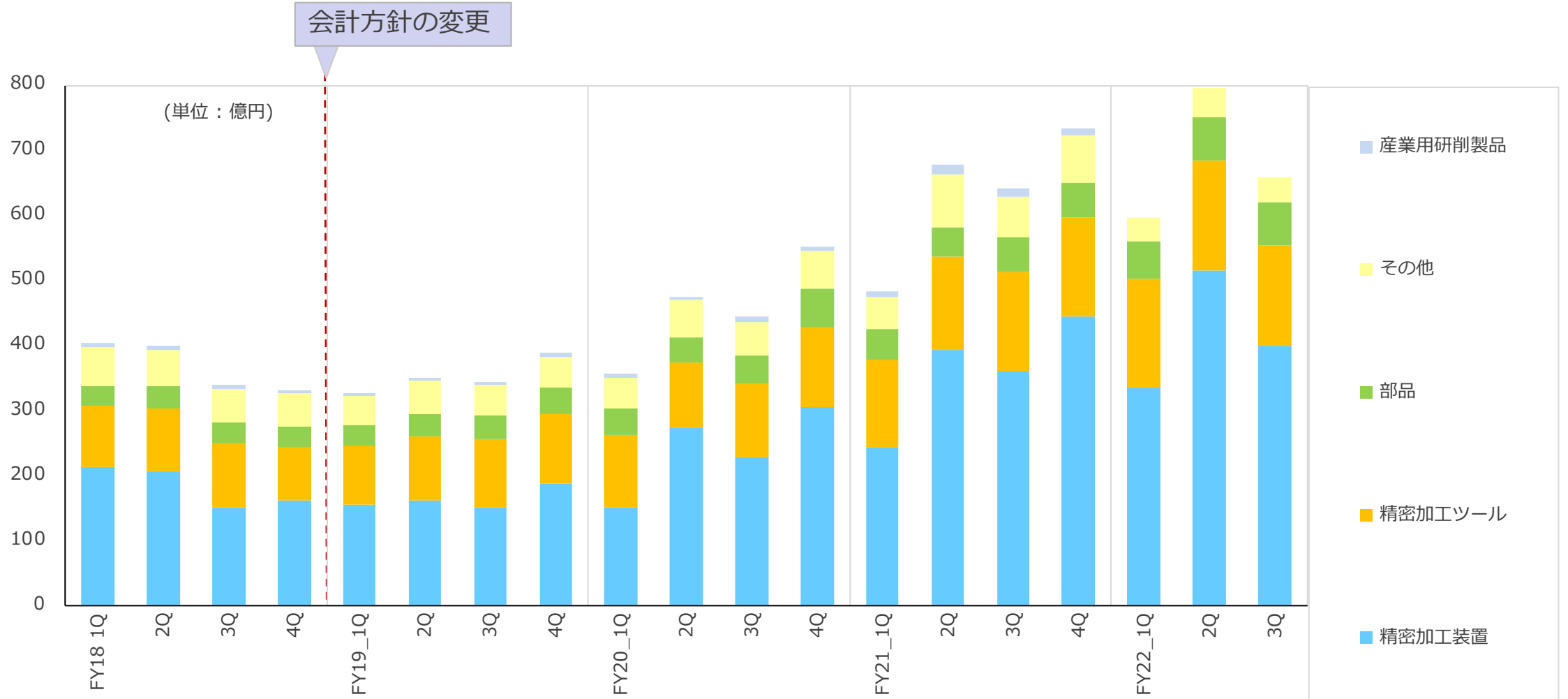
検収タイミングにより売上高が減少するも各利益率は高水準で推移
 (FY22_3Q 営業利益率36.8% 経常利益率34.3% 純利益率25.1%)



※ウェーハマウンタ、純水リサイクル装置など

「その他」および「産業用研削製品」について分類を変更

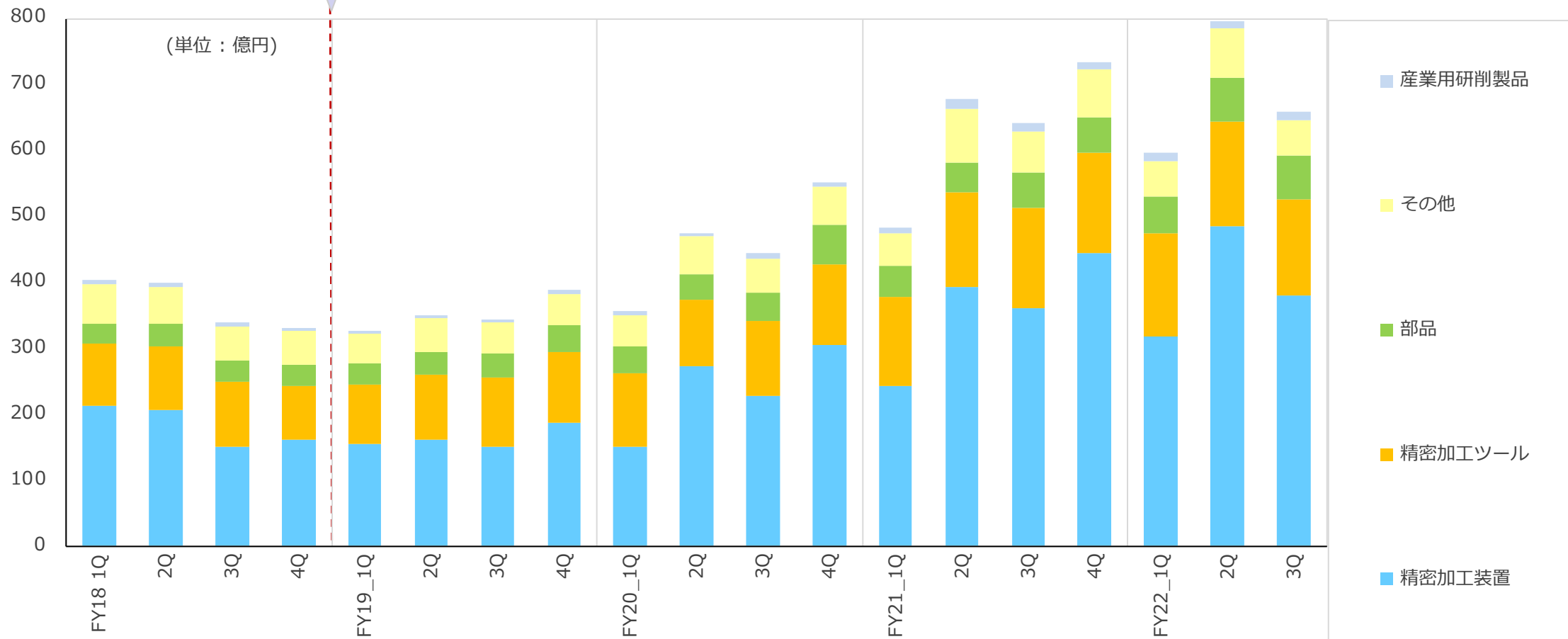
製品群別売上高 四半期推移



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

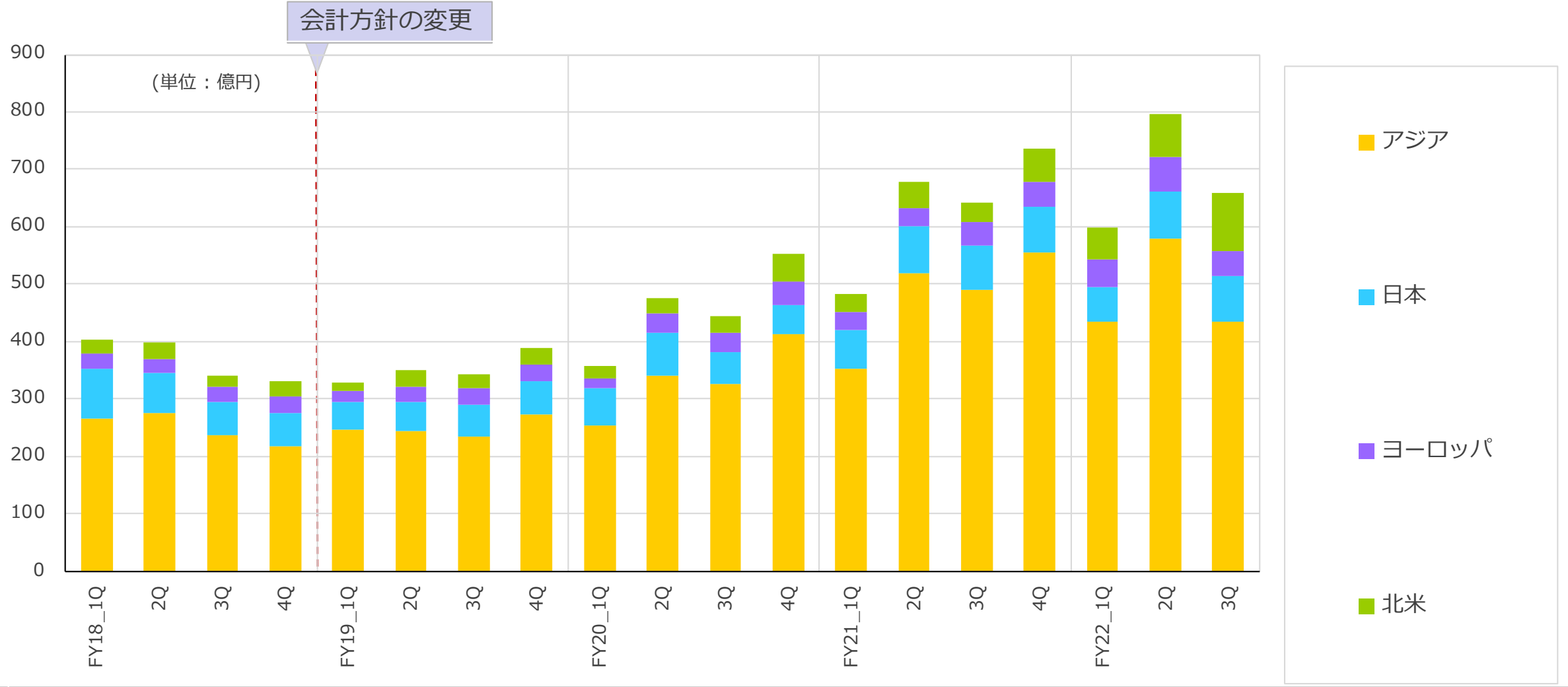
【参考】製品群別売上高 四半期推移

会計方針の変更

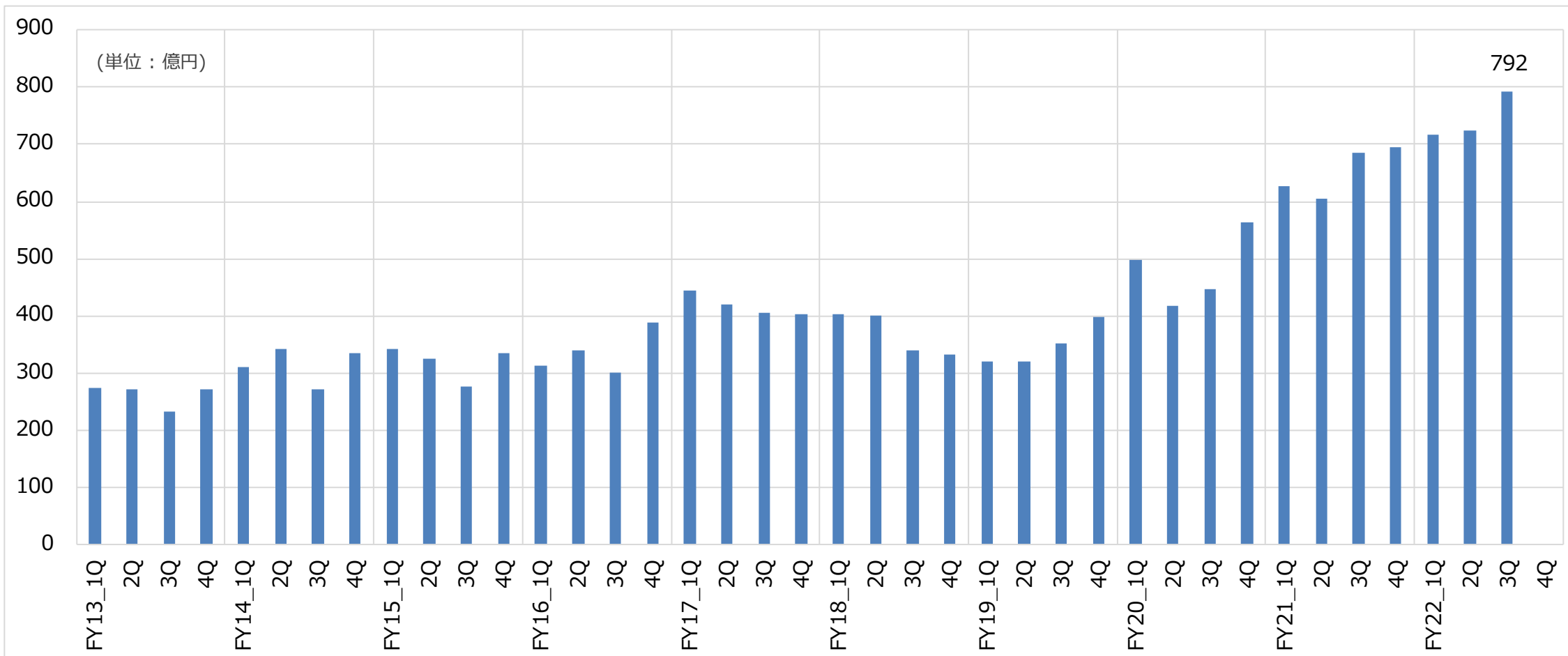


従来分類による推移

地域別売上高 四半期推移

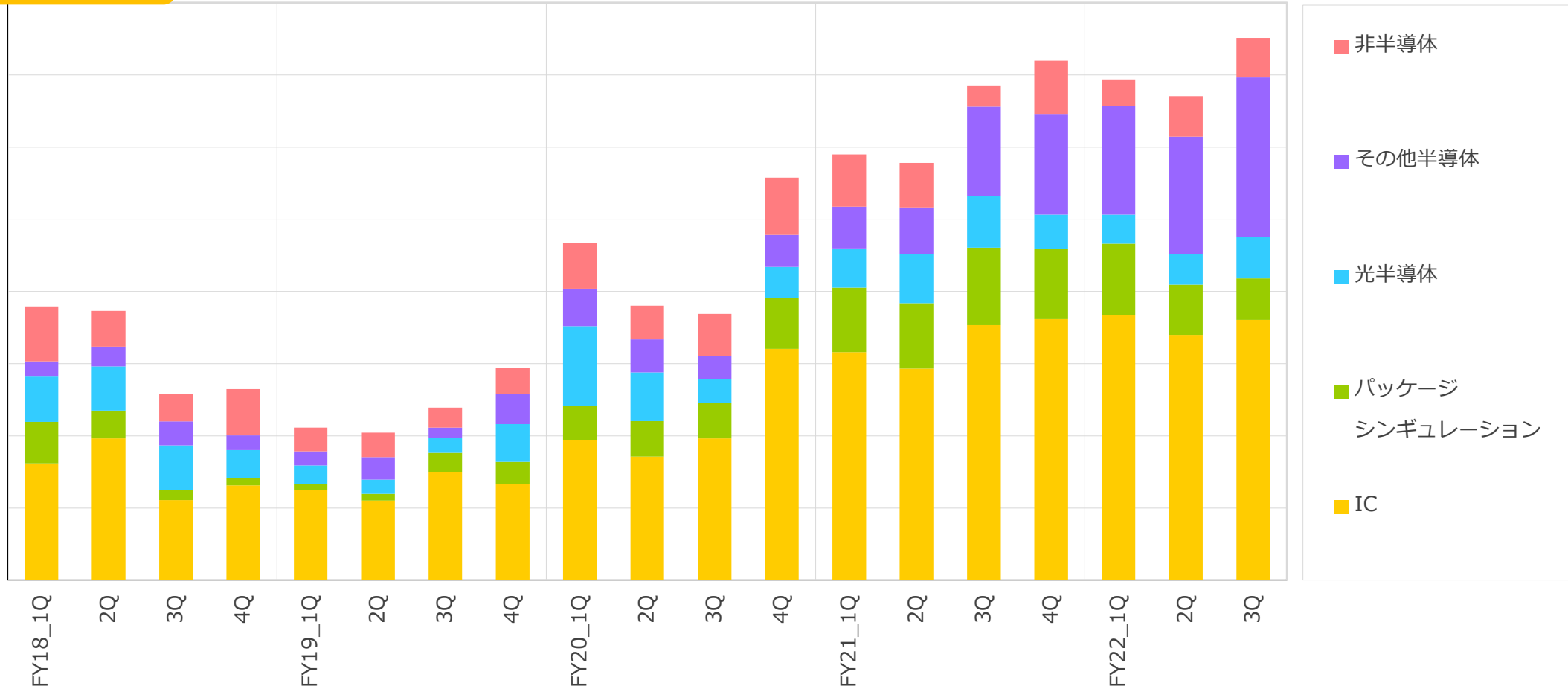


FY22_3Q 海外売上高比率 88.1%



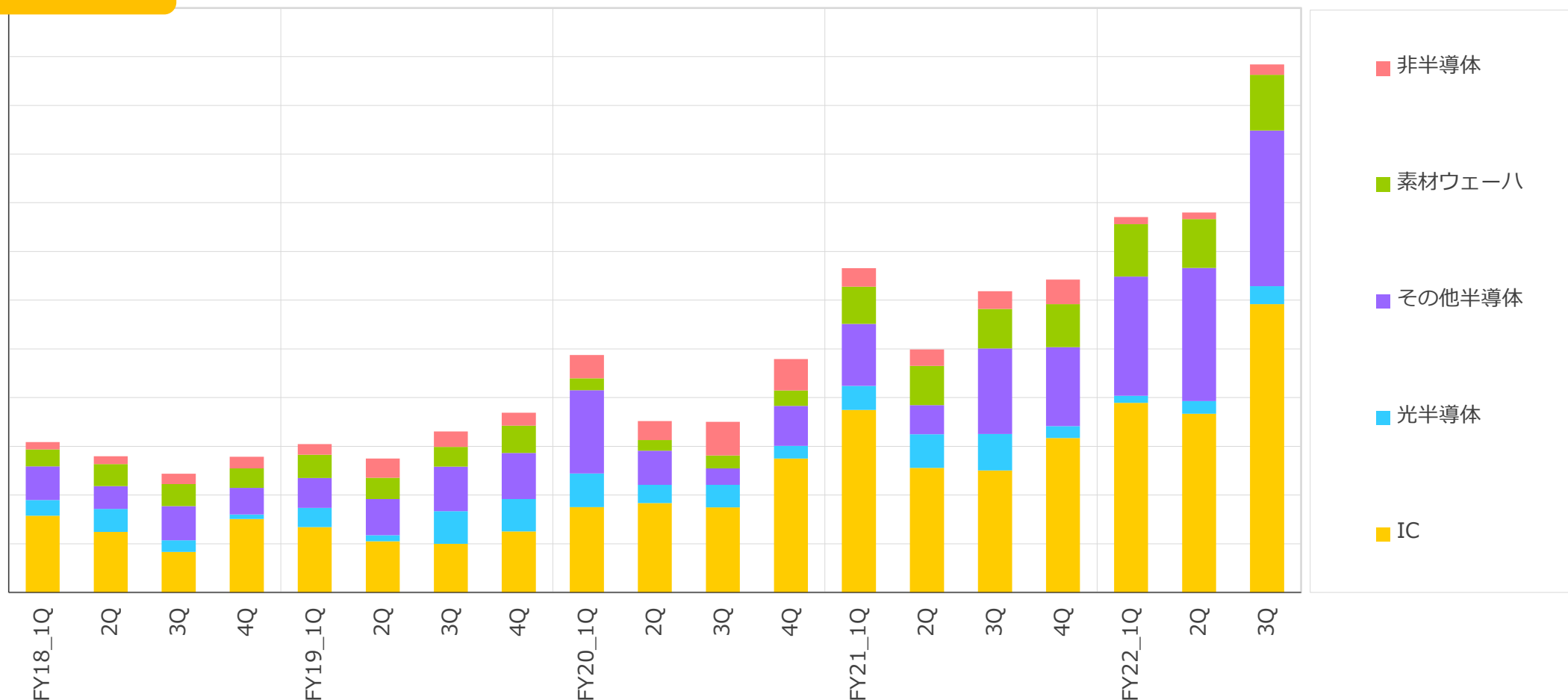
FY22_3Q 出荷額 約792億円

出荷額ベース



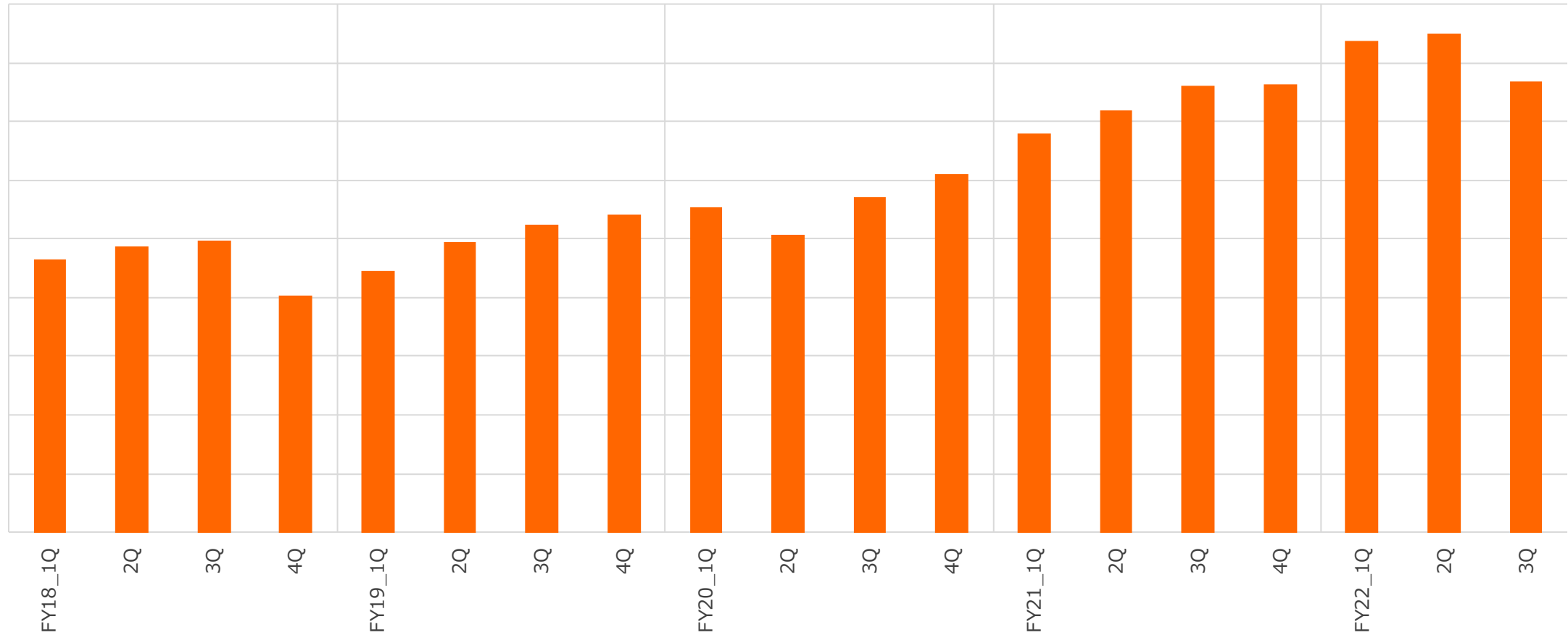
QoQ パワー半導体（その他半導体）が増加
 YoY パワー半導体（その他半導体）の伸びが全体を押し上げた

出荷額ベース

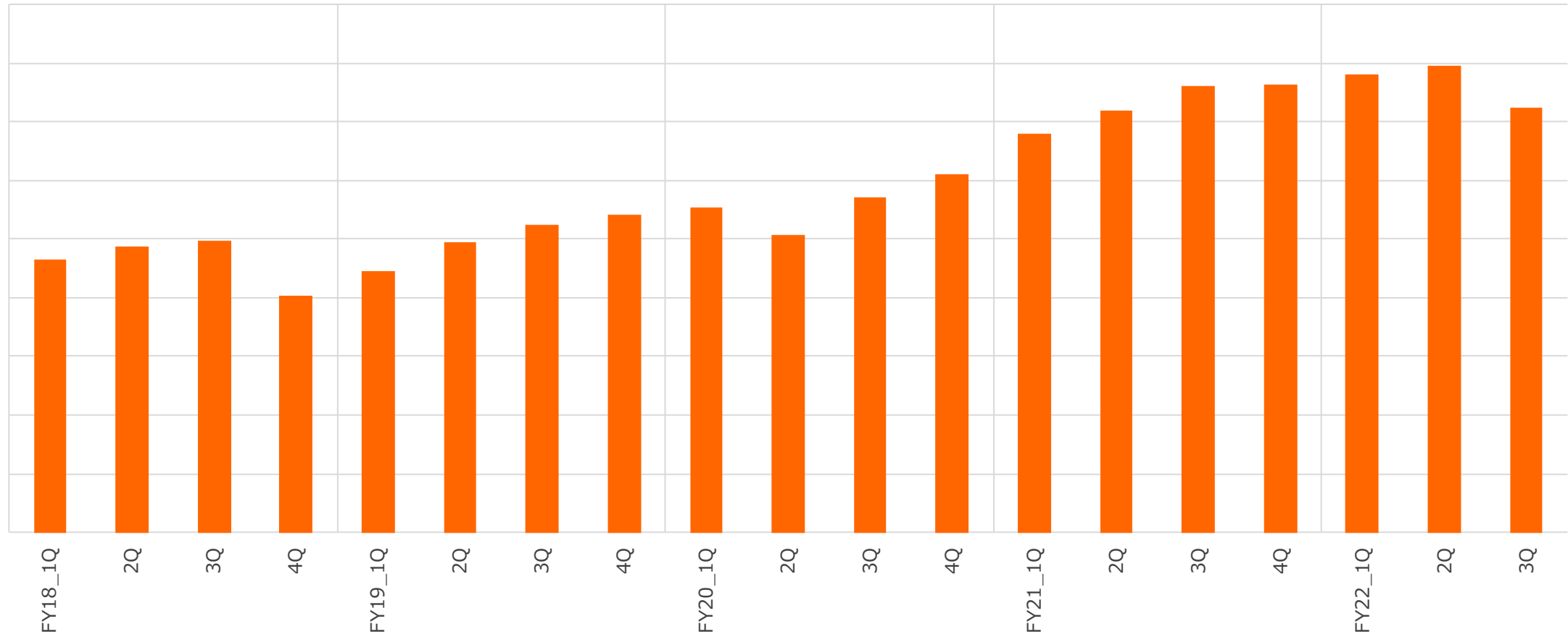


QoQ IC薄化向けの増加が全体を押し上げた

YoY IC、パワー半導体（その他半導体）、素材ウェーハが大幅に増加



精密加工ツール（消耗品）の出荷は顧客の設備稼働率低下などにより減少
※FY22_1Qより、従来他区分だった「関連砥石」を含む



従来分類による推移

(単位：百万円)	FY2022 3Q	FY2022 2Q	差額
現金及び預金	139,576	136,405	3,172
受取手形・売掛金	36,343	41,839	-5,496
棚卸資産	91,013	83,840	7,173
流動資産	274,718	267,867	6,851
有形固定資産	146,332	146,572	-240
固定資産	159,894	160,298	-404
総資産	434,613	428,166	6,447
流動負債	110,743	110,456	287
固定負債	894	932	-38
負債合計	111,638	111,389	249
純資産	322,974	316,776	6,198
負債純資産合計	434,613	428,166	6,447
自己資本比率	74.0%	73.7%	0.3p

総資産：現預金が増加、棚卸資産は原材料および製品在庫が増加
 負債：主に未払法人税等が減少した一方で、電子記録債務が増加
 純資産：主に利益剰余金が増加

(単位：億円)

今回予想

	FY21 1Q	2Q	3Q	4Q	FY22 1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	483	678	642	735	597	795	658	668
営業利益	154	245	233	283	216	333	243	241
経常利益	148	251	240	286	228	348	226	244
純利益	106	180	169	207	160	246	165	175
営業利益率	32.0%	36.2%	36.3%	38.4%	36.1%	41.8%	36.8%	36.0%
経常利益率	30.5%	37.1%	37.4%	38.8%	38.1%	43.8%	34.3%	36.6%
純利益率	21.9%	26.6%	26.4%	28.2%	26.8%	31.0%	25.1%	26.2%
出荷額	627	604	684	694	717	725	792	653

※億円未満 四捨五入

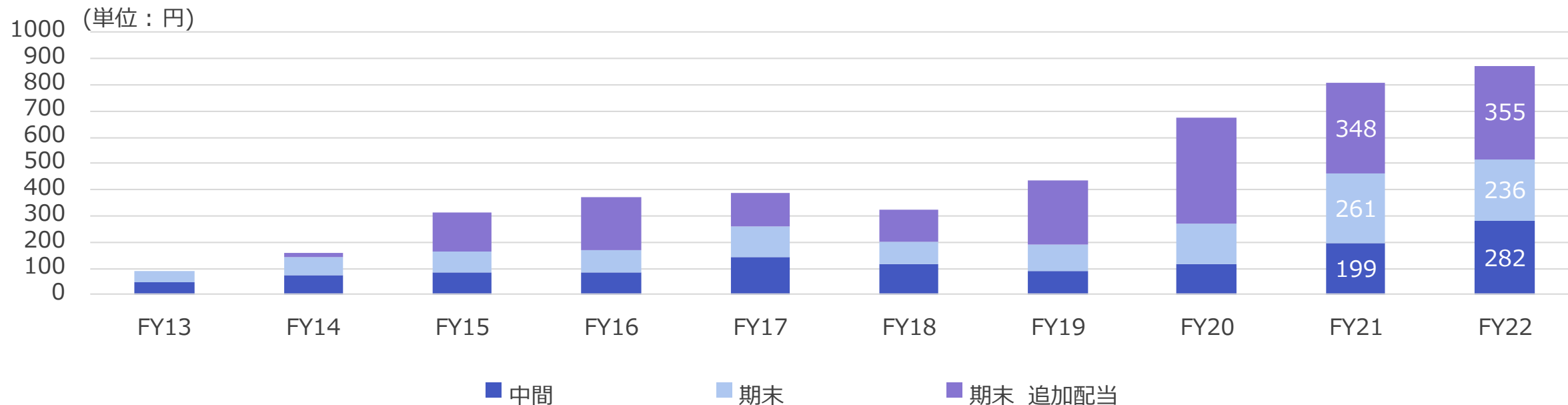
想定為替レート 4Q (1-3月期)
為替感応度 (年換算)

US\$: 120円 Euro : 130円
US\$: 約12億円 Euro : 約3千万円

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 期末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

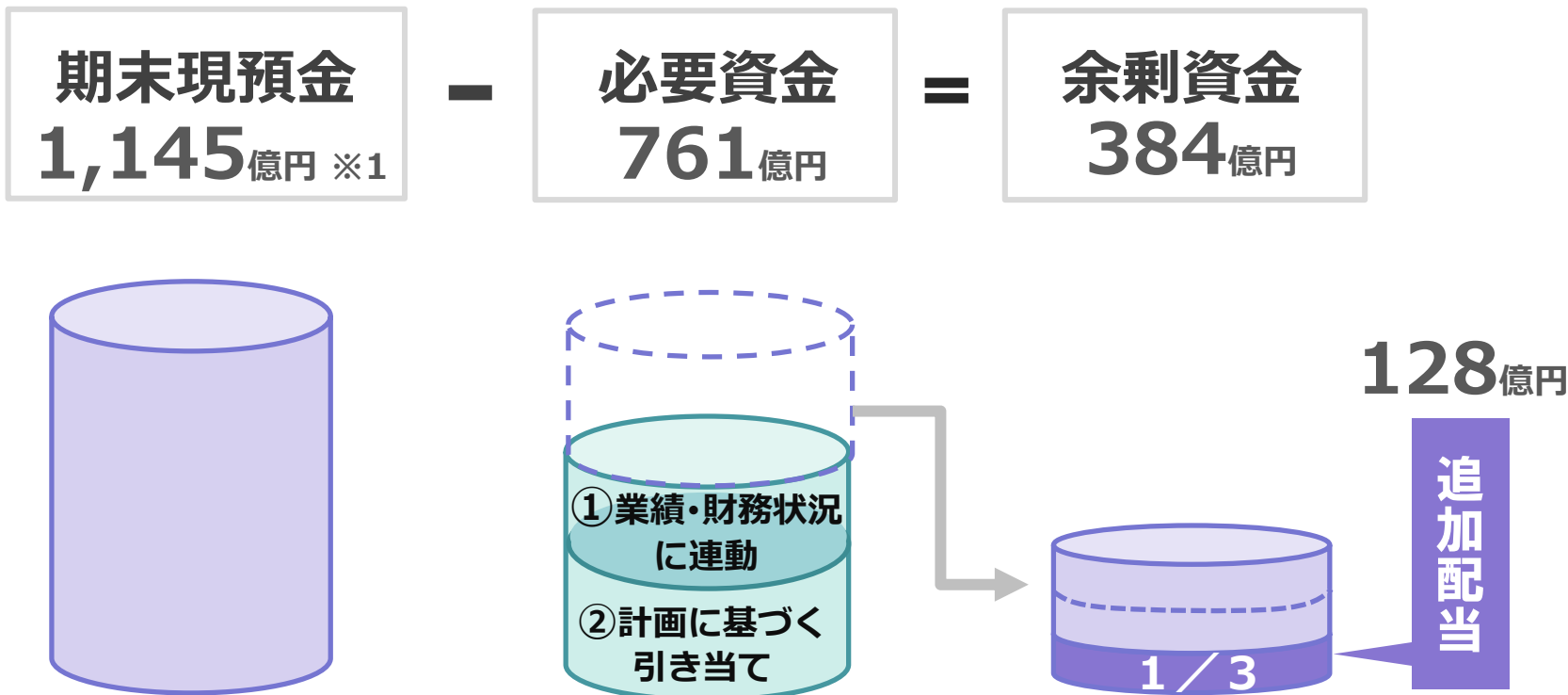
*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



FY22 中間（実績） 282円

期末（予想） 591円

今回予想



必要資金の内訳

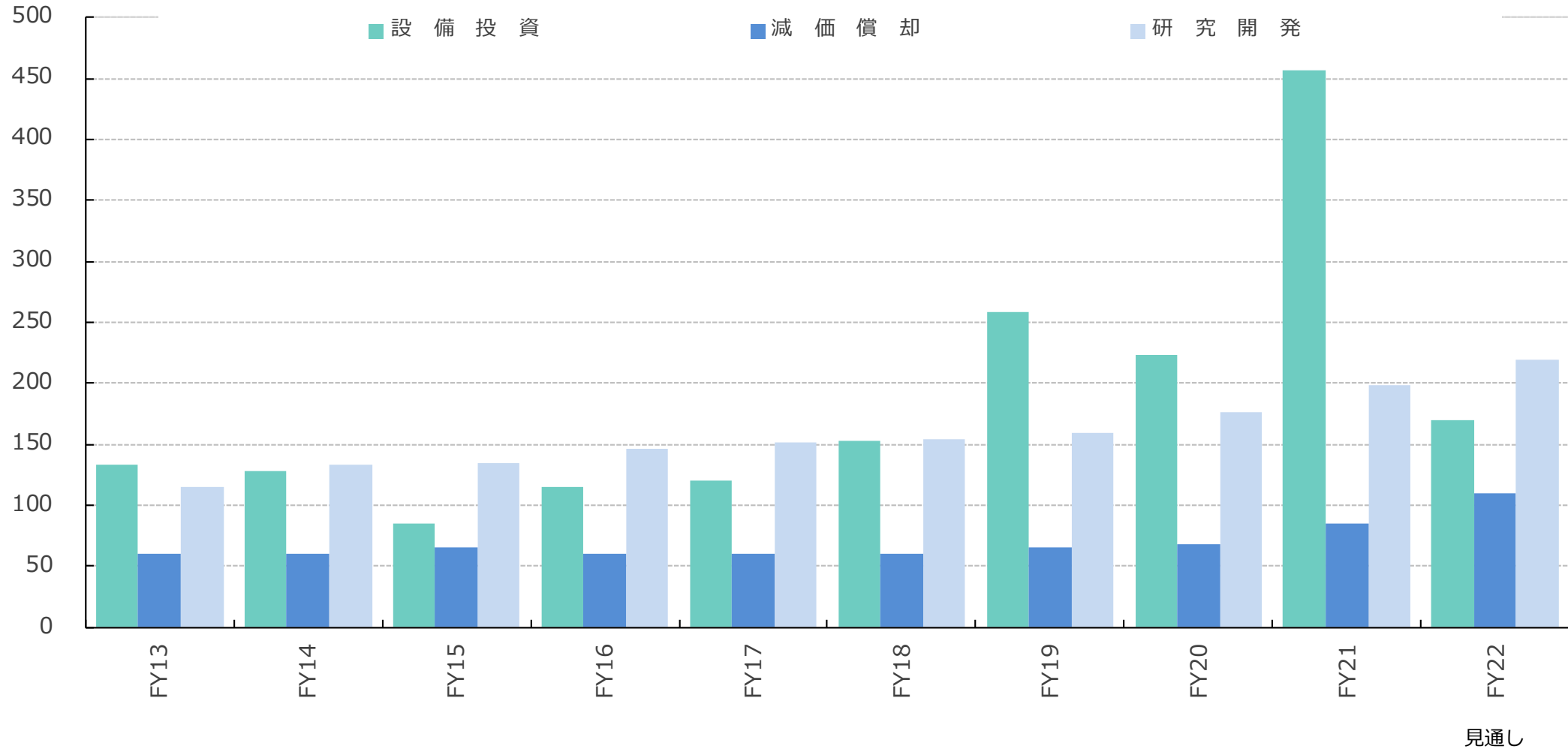
① ① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① ① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て
	① ① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て
	② ① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て
	③ ① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て

① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て
	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て
	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て
	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て	① 業績・財務状況に連動 ② 計画に基づく引き当て

※1 契約負債（前受金）金額などを考慮
 ※2 羽田R&Dセンター取得費用の半額を考慮

出荷額ベース

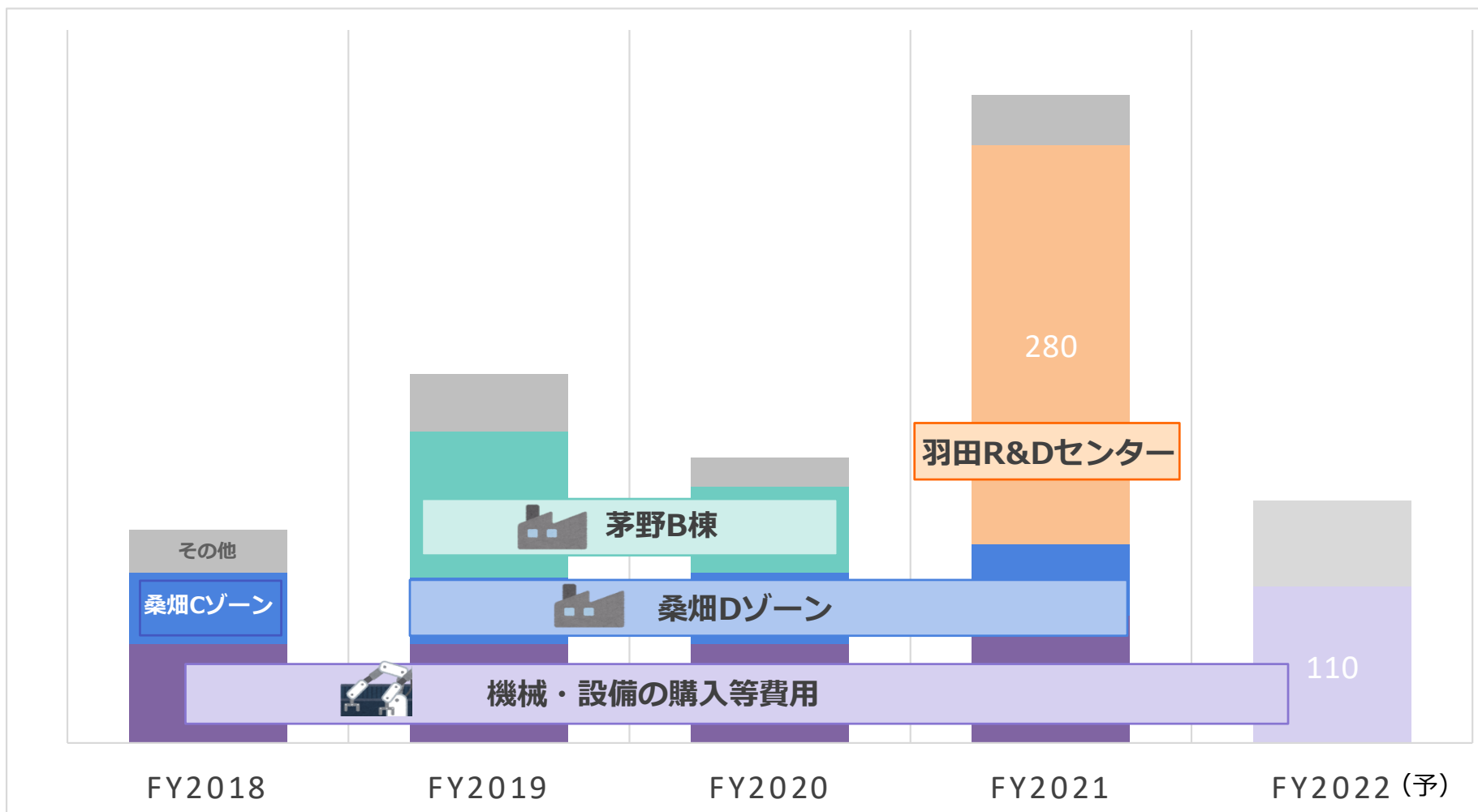
製品群		見通し FY22_4Q 増減率 (QoQ)
	ブレードダイサ	-25%
	レーザソー	-25%
ダイサ		-25%
	薄化DGP	-30%
	薄化以外	10%
グラインダ		-15%
周辺装置		-15%
精密加工装置		-20%
精密加工ツール		-15%
その他		-15%



FY22見通し 設備投資：合理化投資を中心に実施
 減価償却：前年度取得資産の償却
 研究開発：積極的な研究開発を予定

170億円程度 (FY21実績 456億円)
 110億円前後 (FY21実績 85億円)
 220億円前後 (FY21実績 198億円)

単位：億円



FY22見通し

機械・設備の購入等費用
他 オフィス拡張など

約110億円
約60億円

- 製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY
	3Q	3Q	3Q
精密加工装置合計	69%	23%	37%
内、ダイサ	38%	12%	10%
ブレードダイサ	21%	-6%	-2%
レーザソー	17%	46%	28%
内、グラインダ	27%	39%	75%
薄化DGP	16%	45%	67%
薄化以外	12%	32%	88%
内、周辺装置	4%	38%	-
精密加工ツール	20%	-7%	3%
その他	11%	-20%	-34%
出荷額合計	100%	9%	16%

従来分類での構成比、増減率

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY
	3Q	3Q	3Q
精密加工装置合計	65%	22%	29%
内、ダイサ	38%	12%	9%
ブレードダイサ	21%	-6%	-2%
レーザソー	17%	46%	28%
内、グラインダ	27%	39%	75%
薄化DGP	16%	45%	67%
薄化以外	12%	32%	88%
内、周辺装置	-	-	-
精密加工ツール	19%	-7%	-3%
その他	16%	-10%	-3%
出荷額合計	100%	9%	16%

出荷額ベース

構成比		2021年度				2022年度		
製品	用途	21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q	22-1Q	22-2Q	22-3Q
ダイサ	1_IC	54%	51%	52%	50%	53%	51%	48%
	2_パッケージ・シグナレション	15%	16%	16%	13%	14%	10%	8%
	3_光半導体	9%	12%	10%	7%	6%	6%	8%
	4_その他_半導体	10%	11%	18%	19%	22%	24%	29%
	5_非半導体	12%	11%	4%	10%	5%	8%	7%
ダイサ		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
グライнда	1_IC	56%	51%	41%	49%	51%	47%	55%
	2_光半導体	7%	14%	12%	4%	2%	3%	3%
	3_その他_半導体	19%	12%	28%	25%	32%	35%	29%
	4_素材ウエーハ	11%	16%	13%	14%	14%	13%	11%
	5_非半導体	6%	7%	6%	8%	2%	2%	2%
グライнда		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

出荷額ベース

YoY		2021年度				2022年度		
製品	用途	21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q	22-1Q	22-2Q	22-3Q
ダイサ	1_IC	63%	71%	80%	13%	16%	16%	2%
	2_パッケージ・シグナレション	89%	84%	118%	37%	11%	-23%	-47%
	3_光半導体	-51%	1%	115%	12%	-25%	-38%	-20%
	4_その他_半導体	11%	42%	291%	215%	161%	152%	79%
	5_非半導体	15%	32%	-50%	-7%	-50%	-9%	87%
ダイサ		26%	52%	86%	29%	18%	16%	10%
グライнда	1_IC	114%	39%	44%	15%	4%	44%	136%
	2_光半導体	-29%	84%	62%	-6%	-71%	-63%	-51%
	3_その他_半導体	-25%	-15%	419%	97%	92%	360%	82%
	4_素材ウエーハ	210%	265%	204%	179%	41%	24%	40%
	5_非半導体	-20%	-13%	-47%	-22%	-62%	-59%	-41%
グライнда		37%	42%	77%	34%	16%	56%	75%

出荷額ベース

QoQ		2021年度				2022年度		
製品	用途	21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q	22-1Q	22-2Q	22-3Q
ダイサ	1_IC	-1%	-7%	21%	2%	1%	-7%	6%
	2_パッケージ・シグナレション	27%	1%	18%	-10%	3%	-31%	-17%
	3_光半導体	27%	26%	5%	-34%	-15%	4%	36%
	4_その他_半導体	31%	12%	91%	13%	8%	8%	36%
	5_非半導体	-8%	-15%	-52%	150%	-51%	55%	-2%
ダイサ		6%	-2%	19%	5%	-4%	-3%	12%
グライнда	1_IC	36%	-32%	-2%	27%	23%	-6%	61%
	2_光半導体	90%	41%	8%	-67%	-41%	78%	42%
	3_その他_半導体	55%	-53%	195%	-8%	51%	12%	17%
	4_素材ウエーハ	141%	6%	1%	8%	22%	-7%	14%
	5_非半導体	-40%	-12%	8%	38%	-71%	-7%	57%
グライнда		39%	-25%	24%	4%	20%	1%	39%

検収ベース

■ 構成比	FY2021				FY2022			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本	14%	12%	12%	11%	10%	10%	12%	
アメリカ	7%	7%	5%	8%	9%	9%	15%	
アジア	73%	76%	76%	76%	73%	73%	66%	
シンガポール	8%	12%	10%	12%	11%	10%	10%	
台湾	15%	19%	17%	18%	17%	18%	13%	
韓国	12%	7%	7%	9%	14%	10%	7%	
中国 ※	35%	37%	41%	35%	29%	34%	34%	
その他	2%	1%	2%	1%	2%	1%	1%	
ヨーロッパ	6%	4%	6%	6%	8%	7%	7%	
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

※外資メーカー現地工場向け含む

検収ベース

従来分類	FY21_1Q	2Q	3Q	4Q	FY22_1Q	2Q	3Q
精密加工装置	50%	58%	56%	60%	53%	61%	58%
精密加工ツール	28%	21%	24%	21%	26%	20%	22%
部品	10%	7%	8%	7%	10%	8%	10%
その他	10%	12%	10%	10%	9%	9%	8%
産業用研削製品	2%	2%	2%	2%	2%	1%	2%

新分類	FY21_1Q	2Q	3Q	4Q	FY22_1Q	2Q	3Q
精密加工装置	-	-	-	-	56%	65%	61%
精密加工ツール	-	-	-	-	28%	21%	23%
部品	-	-	-	-	10%	8%	10%
その他	-	-	-	-	6%	5%	6%
産業用研削製品	-	-	-	-	-	-	-